

⚠ 使用上の注意事項（ハーメチックシール金属ケース形タンタル固体電解コンデンサ）

1. 使用電圧について

タンタル固体電解コンデンサは定格電圧以下で使用ください。

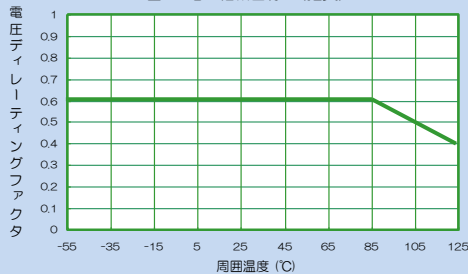
定格電圧：定格電圧とは、定格温度でコンデンサの端子間に連続して印加することができる直流電圧の最大値をいいます。

サージ電圧：サージ電圧とは、定格温度または最高使用温度でコンデンサに瞬間的に印加できる電圧で、6分の周期で、1000Ωの直列抵抗を通して30秒間印加するサイクルを1000回繰り返したとき、耐えることのできる電圧をいいます。

定格電圧VDC	6.3	10	16	20	25	35	50	75	100
サージ電圧VDC	8	13	20	25	32	44	63	98	125

回路設計に際しては、機器の要求信頼度を考慮して適切な電圧軽減をしてください。推奨設計電圧の一例として、NASA APPLICATION NOTEの推奨値を図1に示します。電圧・温度・回路抵抗と故障率の関係については、当社技術資料をご参照ください。

図1 電圧軽減曲線（推奨）



2. 交流成分を含む回路に使用する場合

以下の3項目について特にご注意ください。

- (1) 直流電圧および交流電圧せん頭値の和が定格電圧を超えないこと。
- (2) 交流の半サイクルで許容値を超えた逆電圧がかからないこと。（3項参照）
- (3) リプル電流は許容値を超えないこと。

3. 逆電圧について

タンタル固体電解コンデンサは有極性ですので逆電圧を印加しないで下さい。なお、コンデンサの両端をテスター等でチェックされる場合はテスターの電位（極性）を事前に確認して下さい。

4. 許容リプル電圧

許容リプル電圧は、素子の熱損失とケースおよびリード線の放熱能力により決まるもので、静電容量、リプルの周波数、コンデンサの等価直列抵抗、動作温度等の影響を受けます。許容リプル電圧の値については当社技術資料をご参照ください。

5. 低インピーダンス回路での使用について

0.1Ω/Vの低インピーダンス回路の故障率は1Ω/Vの場合の故障率に比較して約5倍となります。電源フィルタ特にスイッチング電源用その他ノイズバイパス用等の低インピーダンス回路にタンタルコンデンサをご使用の際は、低インピーダンスによる故障率増大を防ぐための使用電圧がコンデンサの定格電圧の1/2以下（1/3以下推奨）になるような定格を選定ください。

6. バイポーラ接続での使用について

許容逆電圧を超える逆電圧がかかる回路、または純交流回路の場合でも下図のようにBACK TO BACKに2個のタンタルコンデンサを接続すればご使用いただけます。BACK TO BACK接続の場合に次の点にご注意ください。

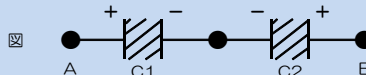
電圧：C1及びC2単独のときの許容リプル電圧を超えないこと。

容量： $(C1 \times C2) / (C1 + C2)$

漏れ電流：右図において

端子Aが（+）になる場合：C1の漏れ電流と同じ

端子Bが（+）になる場合：C2の漏れ電流と同じ



7. はんだ付け

7.1. ハーメチックシール金属ケース形製品の実装条件

111型タンタルコンデンサが対象となります。

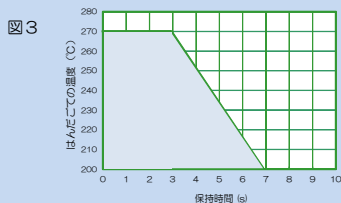
7.2.1 フローはんだ付け（基板下より直接加熱する方法）

はんだ温度…260℃以下

浸せき時間…10秒以下

注 はんだ温度が高い場合や、浸せき時間が長すぎますとハーメチック部分のはんだが溶融することがありますのでご注意ください。

7.2.2 はんだごてによるはんだ付け



注 本体より4mm以上はなれた点ではんだ付けを行ってください。

8. はんだ付け時の過度の加熱によっておきる不具合現象例

実装の際に、上記の許容範囲を超えた過度の加熱を行われますと、以下のような故障現象を引き起こす場合がありますので、十分にご注意ください。

- ・陰極接続に、はんだを使用しているモールド形製品の場合、製品内部のはんだが溶融されると、銀ペーストの中のAgがはんだの中へ溶け込み、DF、高周波インピーダンスの劣化、あるいはその際の内部応力の変化により、漏れ電流増大、ショート等の原因になることがあります。
- ・熱ストレス及び膨張収縮にともなう機械的ストレスあるいは内部応力の集中により、故障率の増加などの原因になることがあります。
- ・ハーメチック封止タイプの111型の場合、封口部のはんだが溶融して、密封不良になる場合があります。あるいは、はんだが流れたり、吸い込まれるとハーメチックシールの内外輪の間がブリッジとなったり、はんだ粒ができていたりしてショートあるいは間欠的ショートなどの現象を起こす場合があります。

9. フラックス

非酸性で塩素分やアミン含有量の極力少ないフラックスをご使用ください。

10. 溶剤洗浄

有機溶剤を用いた洗浄では、その洗浄効果だけを追求することは、コンデンサの外観、機能を損ねる場合があります。当社のコンデンサは2-プロパノールに、20～30℃にて5分間浸せきされても影響はありませんが、新しい洗浄方式の導入又は、洗浄条件の変更等に際しましては当社営業にご相談ください。

11. 樹脂モールド

基板組立後、樹脂注型などでモールドされると、樹脂硬化にともなう発熱および硬化応力、さらにはその後の温度変化によって生じる内部応力により故障の原因となることがありますので、樹脂およびバッファークートの選定は十分事前テストの後行ってください。

12. 振動、落下衝撃

コンデンサを高さ1mのところからコンクリートの床に落下させますと約300Gの過大な衝撃力が加わります。落下させた製品の全てが故障する性質のものではありませんが、故障の原因となり、機器の信頼性を低下させる確率が高くなります。

13. その他注意事項

- ・コンデンサを2個以上直列接続する場合、個々のコンデンサに電圧が均等に分圧できる抵抗器を並列に接続してください。
- ・実装スペースの制約などによるコンデンサの外装材の切削加工は行なわないでください。リード線端子は、プリント配線板(スルーホール)より突出した部分の切断または折り曲げ以外の加工をしないでください。
- ・リード線端子に規定以上の外力を加えないでください。コンデンサに過大な力を加えないでください。
- ・セットのエージングの条件は、コンデンサの定格以下で実施してください。
- ・セット稼働中にコンデンサに直接触れないでください。
- ・コンデンサを分解しないでください。
- ・コンデンサの両端子をテスター等でチェックする場合は、テスターの電位(極性)を事前に確認してください。通電中に電極を当ててチェックする場合には、他の部品等の端子に触れないようにしてください。テスター等の電極でリード線端子を曲げないでください。
- ・セットの使用時、発火、発煙及び異臭が生じた場合、セットの電源を切るか又は電源コードをコンセントからぬいてください。燃焼した場合は顔や手を近づけないでください。
- ・コンデンサがショートをすると高温になり、コンデンサ素子のタンタルが発火する場合があります。この際プリント配線板等を焼損するおそれがあります。なお、金属ケース入りのコンデンサ(111型)では、ショートによりケース内の圧力が上がり破裂し、高温のはんだが飛散する場合があります。
- ・コンデンサは直射日光や埃にさらさないよう梱包した状態で常温常温で保管してください。取り決めた保管期間を経過したコンデンサは、協議の上処置してください。
- ・通電されない状態でのご使用機器は、常温・常温で保管してください。高温度の雰囲気で使用される場合は、防湿処理を行ってください。また、コンデンサ周囲に結露するような使用は避けてください。活性なガス中での使用はコーティング等で、直接ガスがコンデンサに触れないようにしてください。酸やアルカリの雰囲気での使用は避けてください。
- ・コンデンサは各種の金属および樹脂より構成されていますので廃棄にあたっては産業廃棄物として処理してください。
- ・サンプルとしてお求めになったコンデンサは、市販機器に使用しないでください。サンプルは、特定用途(形状見本、電気特性確認用等)に提供しております。

この使用上の注意事項は、電子情報技術産業協会(JEITA)発行の「電子機器用固定タンタル固体電解コンデンサの使用上の注意事項」(EIAJ RCR-2368)を参考に作成いたしました。注意事項の詳細(解説・理由・具体例等)につきましては上記を参照されるか、当社営業担当へお問い合わせください。

NCC 松尾電機株式會社



タンタル固体電解コンデンサに関するご相談は下記へお気軽にお電話下さい。

東日本営業部	: 〒101-0054	東京都千代田区神田錦町1丁目10番1号(サクラビル)	TEL(03)3295-8800	FAX(03)3295-4213
中部日本営業部	: 〒446-0074	愛知県安城市井杭山町一本木5番10号(碧海ビル3F)	TEL(0566)77-3211	FAX(0566)77-1870
西日本営業部	: 〒561-8558	大阪府豊中市千成町3丁目5番3号	TEL(06)6332-0883	FAX(06)6332-0920
海外営業部	: 〒561-8558	大阪府豊中市千成町3丁目5番3号	TEL(06)6332-0883	FAX(06)6332-0920

当カタログの掲載内容は、予告なく変更することがありますので、ご使用に当たっては、弊社営業担当へお問合せの上、仕様のご確認をお願いします。